



平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成31年3月6日

上場会社名 株式会社RS Technologies 上場取引所 東
 コード番号 3445 URL https://www.rs-tec.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 方 永義
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 鈴木 正行 (TEL) 03(5709)7685
 定時株主総会開催予定日 平成31年3月28日 配当支払開始予定日 平成31年3月29日
 有価証券報告書提出予定日 平成31年3月28日
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年12月期の連結業績(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期	25,478	133.1	5,751	92.8	6,141	94.4	3,620	71.4
29年12月期	10,932	23.3	2,982	88.1	3,159	118.8	2,113	145.4

(注) 包括利益 30年12月期 4,301百万円(97.9%) 29年12月期 2,174百万円(154.6%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
30年12月期	294.80	284.47	30.6	25.1	22.6
29年12月期	190.56	182.18	47.6	27.6	27.3

(参考) 持分法投資損益 30年12月期 一百万円 29年12月期 一百万円

※平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年12月期	36,718	29,137	49.5	1,417.95
29年12月期	12,230	5,525	45.1	494.20

(参考) 自己資本 30年12月期 18,160百万円 29年12月期 5,519百万円

※平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産を算定しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
30年12月期	2,669	△22	9,550	14,652
29年12月期	2,744	△202	△1,252	2,916

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
29年12月期	—	0.00	—	5.00	5.00	55	2.6	1.2
30年12月期	—	0.00	—	10.00	10.00	128	3.4	1.0
31年12月期(予想)	—	0.00	—	10.00	10.00		3.5	

3. 平成31年12月期の連結業績予想（平成31年1月1日～平成31年12月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	13,246	15.0	2,678	18.8	2,667	13.6	1,565	8.8	122.19
通期	28,688	12.6	5,971	3.8	6,151	0.2	3,621	0.0	282.72

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有
新規 2社（社名）北京有研RS半導体科技有限公司、有研半導体材料有限公司

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有
② ①以外の会計方針の変更：無
③ 会計上の見積りの変更：無
④ 修正再表示：無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	30年12月期	12,807,700株	29年12月期	11,174,000株
② 期末自己株式数	30年12月期	332株	29年12月期	4,632株
③ 期中平均株式数	30年12月期	12,282,456株	29年12月期	11,088,730株

(注) 平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成30年12月期の個別業績（平成30年1月1日～平成30年12月31日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期	10,557	25.0	2,631	27.2	2,885	26.6	2,066	45.3
29年12月期	8,447	7.9	2,068	29.0	2,279	48.4	1,421	59.7
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
	円 銭		円 銭					
30年12月期	168.23		162.33					
29年12月期	128.20		122.56					

(注) 平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年12月期	20,213	16,817	83.2	1,312.81
29年12月期	9,628	5,348	55.5	478.30

(参考) 自己資本 30年12月期 16,813百万円 29年12月期 5,342百万円

(注) 平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	3
(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
(6) 事業等のリスク	4
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	6
3. 連結財務諸表及び主な注記	7
(1) 連結貸借対照表	7
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	9
(3) 連結株主資本等変動計算書	11
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	13
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	15
(継続企業の前提に関する注記)	15
(会計方針の変更)	15
(セグメント情報等)	17
(1株当たり情報)	20
(重要な後発事象)	21

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度における世界経済は、米国経済が個人消費の増加や雇用環境の改善等を背景に引き続き回復基調となっていました。米中の貿易摩擦の影響により中国経済において設備投資が減少する等、不透明感が増しております。一方、国内においては、年初からの円高の影響はあるものの、企業業績や雇用環境に改善がみられるなど底堅く推移しました。

当社グループを取り巻く事業環境は、半導体製造用プライムウェーハの需給逼迫によるプライムシリコンウェーハの価格上昇の影響を受けて、再生市場においても顧客の需要は拡大しモニタウェーハ及び再生ウェーハの価格が上がるなど、事業環境は好調に推移しました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は25,478,801千円（前年同期比133.1%増）となりました。営業利益は5,751,552千円（前年同期比92.8%増）となり、経常利益は6,141,764千円（前年同期比94.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,620,811千円（前年同期比71.4%増）となりました。

事業のセグメント別の業績を示すと次のとおりです。

(ウェーハ事業)

ウェーハ事業におきましては、再生市場の需要が堅調に推移したことなどから外部顧客への売上高は10,965,985千円（前年同期比15.6%増）、セグメント利益（営業利益）は4,011,957千円（前年同期比18.1%増）となりました。

(プライムシリコンウェーハ製造販売事業)

プライムシリコンウェーハ製造販売事業におきましては、半導体製造用シリコンウェーハの需要が好調に推移したことなどから外部顧客への売上高は11,543,040千円、セグメント利益（営業利益）は2,048,677千円となりました。

(半導体生産設備の買取・販売)

半導体生産設備の買取・販売におきましては、液晶モジュール等の販売が前年より増加したことにより外部顧客への売上高は2,907,989千円（前年同期比110.9%増）、セグメント利益（営業利益）366,377千円（前年同期比182.5%増）となりました。

(その他)

その他におきましては、ソーラー事業及び技術コンサルティングの業績を示しており、外部顧客への売上高は61,786千円（前年同期比8.1%減）、セグメント利益（営業利益）は2,894千円（前年同期比92.8%減）となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

(資産)

当連結会計年度末における流動資産は26,208,512千円となり、前連結会計年度末と比較して18,820,891千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金11,636,157千円、受取手形及び売掛金4,042,695千円の増加によるものであります。

固定資産は10,510,050千円となり、前連結会計年度末と比較して5,666,778千円増加いたしました。これは主に、これは主に合弁会社を設立したことによる建物及び構築物（純額）1,134,240千円の増加及び機械装置及び運搬具（純額）2,374,819千円の増加によるものであります。

この結果、総資産は36,718,562千円となり、前連結会計年度末に比べて24,487,670千円増加いたしました。

(負債)

当連結会計年度末における流動負債は4,979,096千円となり、前連結会計年度末と比較して1,608,875千円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金1,155,468千円の増加、未払金1,015,357千円の増加によるものであります。

固定負債は2,601,520千円となり、前連結会計年度末と比較して733,251千円減少いたしました。これは主に、長期借入金918,492千円の減少と固定負債その他73,996千円の増加によるものであります。

この結果、負債合計は7,580,616千円となり、前連結会計年度末に比べ875,623千円増加いたしました。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は29,137,946千円となり、前連結会計年度末と比較して23,612,047千円増加いたしました。これは主に公募増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ4,727,732千円増加したこと、親会社株主に帰属する当期純利益による利益剰余金3,564,943千円の増加、為替換算調整勘定380,700千円の減少、合弁会社を設立したことに伴う非支配株主持分10,973,859千円の増加によるものであります。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前連結会計年度末の2,916,087千円より11,736,908千円増加し、14,652,995千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、2,669,892千円（前連結会計年度は2,744,501千円の増加）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益6,406,932千円、減価償却費1,298,459千円、売上債権の増加額1,625,708千円、たな卸資産の増加額1,010,567千円、法人税等の支払額1,980,797千円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、22,216千円（前連結会計年度は202,443千円の減少）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出1,272,620千円と貸付けによる支出400,000千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入1,921,203千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、9,550,292千円（前連結会計年度は1,252,974千円の減少）となりました。

これは主に、株式発行による収入9,453,316千円と非支配株主からの払込みによる収入1,671,000千円、長期借入金の返済による支出1,356,521千円によるものであります。

(4) 今後の見通し

今後、米中貿易摩擦の影響や国際金融市場の大幅な変動等による世界経済の不透明感は続き、景気下振れリスクは存在するものと見込まれますが、米国経済における個人消費の増加が引き続き底堅く推移するものと予想されます。

このような環境の下、当社グループではウェーハ再生市場は引き続き堅調に推移するものと見込んでおり、当社の強みでもある長年の経験で培ってきた再生加工技術により再生市場のシェア拡大に努めてまいります。

また、中国子会社である北京有研RS半導体科技有限公司において、生産力拡大等により引き続き中国国内の半導体事業を推進することで、中国半導体市場のシェア拡大に努めてまいります。

これらの取り組みにより翌連結会計年度の業績は、売上高286億88百万円（当連結会計年度比12.6%増）、営業利益59億71百万円（当連結会計年度比3.8%増）、経常利益61億51百万円（当連結会計年度比0.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益36億20百万円（当連結会計年度比0.0%増）と予想しております。

(注) 本決算短信の中で記述しております業績見通しなど将来についての事項は、予測しえない経済状況の変化等さまざまな要因があるため、その結果について当社グループが保証するものではありません。

(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

株主に対する利益の還元は、当社にとって最も重要な経営課題の1つとして認識しており、配当に関しては、各事業年度における利益水準、中期計画の見通し、財務体質の強化等の状況を総合的に勘案した上で、柔軟に対応していく方針であります。

上記の方針に基づき、当期の期末配当金につきましては普通株式1株当たり10円を予定しております。

次期の配当については現時点では未定であります。基本方針に従い、株主に対する適切な利益還元を検討する予定であります。

(6) 事業等のリスク

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものでない点に留意する必要があります。なお、文中の将来に関する事項は、決算発表日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 特定の取引先への依存に関するリスク

当社グループは、世界有数の半導体受託生産企業であるTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSMC) との円滑な取引を継続しており、同社に対する売上が当社設立以来高い水準となっております。

従って、同社の販売及び設備投資の動向によっては当社グループの短期的な経営成績に影響を与える可能性があります。

(2) 業界動向に関するリスク

当社グループの主な需要先は半導体業界であります。需給の変動があった場合、シリコンウェーハの使用量の減少や販売価格の低下により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(3) 他社との競合に関するリスク

当社グループの主たる事業領域である半導体市場は、国内外を問わず厳しい競合環境にあり、同業他社との間では価格、品質、顧客対応能力、新製品開発力等、様々な局面での競争が展開されています。

当社グループは、ウェーハ事業において高い価格競争力を有する様々なテスト用半導体ウェーハを手掛けることにより、収益源を確保すると共に半導体需給や技術動向の把握及び顧客層や製品分野の拡大を図っていますが、高シェア製品の市場支配力が低下することにより競争上の地位が低下した場合、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

(4) 外注先の品質管理に関するリスク

当社グループは、ウェーハ事業の加工工程を外部企業に一部委託しています。当社グループでは、委託先企業の経営状況、技術水準、製造能力について継続的に監視していますが、委託先企業が、必要な技術的・経済的資源を維持するとともに十分な製品の品質を保ち、当社グループが求める水準の委託業務を遂行できる保証はありません。

また、これらの委託先において何らかの理由により事業が中断された場合、当社グループ製品の加工及び製品の供給に影響を与える可能性があります。

(5) 加工工程に関するリスク

当社グループの主たる事業領域である半導体市場では、製品価格が継続的に低下する傾向にあります。当社グループでは、生産プロセスの見直し等により生産効率の向上を進め、製品価格低下の影響を緩和するように努めていますが、一般的に生産効率の向上には限界があるため、製品価格の低下が続き、かつ、継続的に生産効率を向上させることができなくなった場合、利益が圧迫される可能性があります。さらに、加工工程において、何らかの理由により加工活動が中断してしまった場合、生産能力低下や納期遅延が発生し、ウェーハの供給が困難となる可能性があります。当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

(6) 設備投資及び資金調達に関するリスク

当社グループは、市場動向、需要動向等を見極めながら、事業戦略及び当該投資の収益性等を勘案しつつ必要な設備投資を実施していく方針です。

大規模な設備投資を行った場合、製造ラインの調整等を行う必要があることから、本格的な生産に至るまでには一定の期間を要するため、製造設備の新設・増設に伴う立上げ費用や減価償却費が先行的に発生することになります。

また、多額の設備投資を実施した場合、減価償却費等が大幅に増加する可能性があります。

これらの要因により、今後当社グループの利益率が大幅に悪化する可能性があります。また、当該設備投資を行う際に想定していた受注を期待通りに獲得できなかった場合には、当社グループの経営成績等は重大な影響を受ける可能性があります。

また、当社グループは、事業展開の必要に応じて機動的な資金調達を実施していく方針ですが、当該資金調達に際しては、当社グループの財政状態、収益性等のほか、金利水準や市場環境等の要因により、当社グループが希望する時期または条件により資金調達を実行できない場合があり、そのような場合には、必要な設備投資を行うことができず、事業計画等において想定していた収益を上げられない可能性があります。当社グループの事業、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。

(7) 為替の変動に関するリスク

当社グループの海外売上高は、高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産及び負債の評価は為替相場の変動により影響を受けております。このため、為替相場の急激な変動によっては当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(8) 特定人物への依存に関するリスク

現在、当社グループの経営は代表取締役社長である方永義を含めた8名の取締役と3名の監査役で構成される経営陣で運営されており、代表取締役社長である方永義個人に依存した組織ではありません。しかしながら、同氏は、前職（株式会社永輝商事代表取締役）までの経営者としての経験・人脈を生かし、当社グループの新規営業先の開拓、グローバルな事業展開において重要な役割を果たしております。同氏への依存を軽減するための経営構造の改革過程で、何らかの理由により同氏の業務遂行が困難となった場合には、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

(9) 事故、災害等による操業への影響に関するリスク

当社グループの生産設備の中には、ウェーハ事業の炉など高温、高圧での操業を行なっている設備があります。また、ウェーハを加工するうえで多量の化学薬品等を取り扱っています。対人・対物を問わず、事故の防止対策には万全を期しておりますが、万一重大な事故が発生した場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、国内外の製造拠点等において、大規模地震や台風等の自然災害、新型インフルエンザ等の感染症、その他当社グループの制御不能な事態により操業に支障が生じた場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

(10) 財務制限条項に関するリスク

当社は、事業に必要な資金調達のため、金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しており、これらの借入契約には、純資産の維持及び経常利益の確保に関して財務制限条項が付加されております。今後、当社グループの経営成績が著しく悪化するなどして財務制限条項に抵触した場合、借入先金融機関の請求により当該借入について期限の利益を喪失し、一括返済を求められるなどして、財政状況及び業績等に影響を与える可能性があります。

(11) 有利子負債への依存及び金利水準の動向に関するリスク

当社グループは、主に金融機関からの借入金によって事業資金を調達しており、有利子負債を多く抱えております。当社グループでは、金利等の動向を注視しつつ、将来の環境変化にも柔軟な対応が可能な調達形態の維持・構築に努めております。しかしながら、事業の規模拡大に伴う資金需要により、有利子負債の割合が上昇するとともに、金利水準の上昇により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(12) M&A、事業提携に関するリスク

当社グループは、今後の業容拡大等においてM&A及び事業提携戦略は重要かつ有効であると認識しております。M&Aや事業提携を行う場合においては、対象会社を慎重に検討し、対象会社の財務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって、極力リスクを回避するように努める方針としておりますが、買収後に偶発債務の発生等、未認識の債務が判明する可能性も否定できません。また、のれんが発生する場合はその償却額を超過する収益力が安定的に確保できることを前提としておりますが、買収後の事業環境や競合状況の変化等により買収当初の事業計画遂行に支障が生じ、計画どおりに進まない場合は当該のれんに係る減損損失等の損失が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当連結会計年度 (平成30年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,243,026	14,879,183
受取手形及び売掛金	2,915,649	6,958,345
商品及び製品	446,405	1,343,775
仕掛品	112,882	645,080
原材料及び貯蔵品	321,660	1,466,996
繰延税金資産	97,379	133,905
その他	254,536	821,528
貸倒引当金	△3,920	△40,302
流動資産合計	7,387,620	26,208,512
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,612,373	3,380,865
減価償却累計額	△193,992	△828,244
建物及び構築物 (純額)	1,418,381	2,552,621
機械装置及び運搬具	4,942,760	19,108,431
減価償却累計額	△1,787,429	△13,578,281
機械装置及び運搬具 (純額)	3,155,331	5,530,150
工具、器具及び備品	101,335	141,178
減価償却累計額	△56,125	△105,597
工具、器具及び備品 (純額)	45,209	35,581
リース資産	63,804	65,150
減価償却累計額	△14,887	△26,977
リース資産 (純額)	48,916	38,172
建設仮勘定	6,568	807,014
有形固定資産合計	4,674,406	8,963,539
無形固定資産		
ソフトウェア	19,599	12,887
その他	—	1,087,055
無形固定資産合計	19,599	1,099,942
投資その他の資産		
投資有価証券	—	114,599
破産更生債権等	6,831	6,831
繰延税金資産	—	1,251
その他	301,322	427,649
貸倒引当金	△158,889	△103,764
投資その他の資産合計	149,265	446,567
固定資産合計	4,843,271	10,510,050
資産合計	12,230,892	36,718,562

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当連結会計年度 (平成30年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	398,537	1,554,006
短期借入金	315,400	97,200
1年内返済予定の長期借入金	950,688	866,859
リース債務	10,908	12,177
未払金	368,776	1,384,133
未払法人税等	968,871	688,615
賞与引当金	107,214	130,284
株主優待引当金	8,039	18,135
その他	241,784	227,684
流動負債合計	3,370,221	4,979,096
固定負債		
長期借入金	2,767,022	1,848,529
役員退職慰労引当金	—	5,600
退職給付に係る負債	—	2,475
リース債務	31,383	23,405
繰延税金負債	527,178	638,326
その他	9,187	83,183
固定負債合計	3,334,772	2,601,520
負債合計	6,704,993	7,580,616
純資産の部		
株主資本		
資本金	645,850	5,373,582
資本剰余金	645,840	5,373,572
利益剰余金	4,176,371	7,741,315
自己株式	△6,357	△871
株主資本合計	5,461,704	18,487,598
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	—	△4,857
為替換算調整勘定	58,181	△322,518
その他の包括利益累計額合計	58,181	△327,375
新株予約権	6,013	3,864
非支配株主持分	—	10,973,859
純資産合計	5,525,899	29,137,946
負債純資産合計	12,230,892	36,718,562

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
売上高	10,932,483	25,478,801
売上原価	6,680,142	17,112,514
売上総利益	4,252,340	8,366,286
販売費及び一般管理費	1,269,941	2,614,734
営業利益	2,982,399	5,751,552
営業外収益		
受取利息	2,257	113,007
為替差益	1,293	300,657
補助金収入	234,360	26,060
貸倒引当金戻入額	29,591	55,125
その他	20,434	35,063
営業外収益合計	287,936	529,914
営業外費用		
支払利息	70,435	73,886
支払手数料	11,499	56,605
シンジケートローン手数料	26,500	3,000
その他	1,965	6,209
営業外費用合計	110,399	139,702
経常利益	3,159,937	6,141,764
特別利益		
負ののれん発生益	—	265,168
特別利益合計	—	265,168
税金等調整前当期純利益	3,159,937	6,406,932
法人税、住民税及び事業税	1,054,233	1,359,166
法人税等調整額	△7,326	△190,256
法人税等合計	1,046,907	1,168,909
当期純利益	2,113,030	5,238,022
非支配株主に帰属する当期純利益	—	1,617,211
親会社株主に帰属する当期純利益	2,113,030	3,620,811

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
当期純利益	2,113,030	5,238,022
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	△4,857
為替換算調整勘定	61,154	△931,185
その他の包括利益合計	61,154	△936,042
包括利益	2,174,184	4,301,980
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	2,174,184	3,235,253
非支配株主に係る包括利益	—	1,066,726

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自平成29年1月1日至平成29年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	629,450	629,440	2,118,390	△8,550	3,368,729
当期変動額					
新株の発行	16,400	16,400			32,800
剰余金の配当			△55,048		△55,048
自己株式の取得				△741	△741
自己株式の処分				2,934	2,934
親会社株主に帰属する当期純利益			2,113,030		2,113,030
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	16,400	16,400	2,057,981	2,192	2,092,974
当期末残高	645,850	645,840	4,176,371	△6,357	5,461,704

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘 定	その他の包括利 益累計額合計			
当期首残高	—	△2,972	△2,972	6,013	—	3,371,770
当期変動額						
新株の発行						32,800
剰余金の配当						△55,048
自己株式の取得						△741
自己株式の処分						2,934
親会社株主に帰属する当期純利益						2,113,030
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	61,154	61,154	—	—	61,154
当期変動額合計	—	61,154	61,154	—	—	2,154,128
当期末残高	—	58,181	58,181	6,013	—	5,525,899

当連結会計年度（自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	645,850	645,840	4,176,371	△6,357	5,461,704
当期変動額					
新株の発行	4,727,732	4,727,732			9,455,465
剰余金の配当			△55,868		△55,868
自己株式の取得					—
自己株式の処分				5,485	5,485
親会社株主に帰属する当期純利益			3,620,811		3,620,811
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	4,727,732	4,727,732	3,564,943	5,485	13,025,894
当期末残高	5,373,582	5,373,572	7,741,315	△871	18,487,598

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘 定	その他の包括利 益累計額合計			
当期首残高	—	58,181	58,181	6,013	—	5,525,899
当期変動額						
新株の発行				△2,148		9,453,316
剰余金の配当						△55,868
自己株式の取得						—
自己株式の処分						5,485
親会社株主に帰属する当期純利益						3,620,811
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△4,857	△380,700	△385,557	—	10,973,859	10,588,301
当期変動額合計	△4,857	△380,700	△385,557	△2,148	10,973,859	23,612,047
当期末残高	△4,857	△322,518	△327,375	3,864	10,973,859	29,137,946

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,159,937	6,406,932
減価償却費	714,469	1,298,459
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△28,932	△18,742
賞与引当金の増減額 (△は減少)	83,930	28,033
株主優待引当金の増減額 (△は減少)	△5,758	10,095
受取利息及び受取配当金	△2,257	△113,415
補助金収入	△234,360	△26,060
負ののれん発生益	—	△265,168
為替差損益 (△は益)	△53,784	△29,403
支払利息	70,435	73,886
シンジケートローン手数料	26,500	3,000
売上債権の増減額 (△は増加)	△367,699	△1,625,708
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△226,544	△1,010,567
仕入債務の増減額 (△は減少)	110,731	△95,984
未払金の増減額 (△は減少)	81,733	△248,898
未払費用の増減額 (△は減少)	—	△270,358
その他	△105,429	469,191
小計	3,222,971	4,585,292
利息及び配当金の受取額	2,057	113,415
補助金の受取額	234,360	26,060
利息の支払額	△52,936	△74,078
法人税等の支払額	△661,950	△1,980,797
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,744,501	2,669,892
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△84,739	△186,874
定期預金の払戻による収入	—	212,635
有形固定資産の取得による支出	△100,677	△1,272,620
無形固定資産の取得による支出	△4,653	△55,600
貸付けによる支出	—	△400,000
敷金及び保証金の差入による支出	△10,330	—
敷金及び保証金の回収による収入	982	—
保険積立金の積立による支出	△7,219	△7,219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△136,118
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	1,921,203
その他	4,195	△97,623
投資活動によるキャッシュ・フロー	△202,443	△22,216

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△282,220	△654,495
長期借入れによる収入	498,150	500,000
長期借入金の返済による支出	△1,413,388	△1,356,521
株式の発行による収入	32,800	9,453,316
シンジケートローン手数料の支払額	△26,500	△3,000
自己株式の取得による支出	△741	—
自己株式の売却による収入	2,934	5,485
配当金の支払額	△54,965	△55,868
非支配株主からの払込みによる収入	—	1,671,000
リース債務の返済による支出	△11,479	△9,624
その他	2,436	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,252,974	9,550,292
現金及び現金同等物に係る換算差額	△87,248	△461,060
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,201,835	11,736,908
現金及び現金同等物の期首残高	1,714,252	2,916,087
現金及び現金同等物の期末残高	2,916,087	14,652,995

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前題に関する注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

(企業結合等関係)

(金銭出資による会社の取得)

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称 北京有研RS半導体科技有限公司

事業の内容 半導体硅材料の開発及び販売。半導体関連設備及び材料の開発及び販売。技術移転、技術相談、技術サービス、輸出入業務。

(2) 企業結合を行った主な理由

本件契約を締結することになった当事会社の1社であるGRINMは、1952年に創立された、中国の非鉄金属産業の分野で最も大きな研究開発機関(2000年に国有企業化)です。傘下に非鉄金属分野に関連する多数の企業を抱える中国有数の企業集団であり、その100%子会社であるGRITEKは、GRINMの第1号事業会社であり、シリコンインゴットやプライムウェーハの製造販売を主な事業としております。当社が、GRINM等と合弁で設立する北京有研RS半導体科技有限公司を通じてGRITEKを子会社化することで、以下のメリットを得ることができると考えております。① 中国市場におけるプライムウェーハ製造等、非鉄金属分野で有数の企業集団であるGRINMが有する信用力・知名度を生かし、プライムウェーハ製造販売事業への参入と中国再生市場におけるシェア拡大が可能になる。② 中国国有企業であるGRINM(中央直属企業64番目)が筆頭株主となることで、北京有研RS半導体科技有限公司も中国が国家主導で実施していく半導体産業への積極投資の恩恵を受けることができる。③ 当社及びGRITEKが加盟している集成电路材料産業革新戦略連盟のネットワークを通じて、半導体生産設備・材料等の取引拡大が見込まれる。④ 当社のグローバルネットワークを介し、世界の顧客へアプローチすることで、プライムウェーハ製造販売事業の拡大が期待できる。

当社は、本件を契機として、2025年まで視野に入れた中国政府が主導する「中国製造2025」で示された半導体ビジネス機会を大々的に取り込み、プライムウェーハ中国国内立地化に際し、中国政府との関係が深いGRINMと組むことで、中国でのプライムウェーハ製造販売事業を推進してまいります。また、当社としてはビジネスリスクを最小限にとどめながら、拡大する中国市場において、さらなる企業価値向上に努めてまいります。

(3) 企業結合日

平成30年1月30日

(4) 企業結合の法的形式

金銭による出資

(5) 結合後企業の名称

北京有研RS半導体科技有限公司

(6) 取得した出資比率

46.2%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

北京有研RS半導体科技有限公司の意思決定機関を当社が実質的に支配していると認められるためです。

2. 当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	7,267,628千円
取得原価		7,267,628千円

4. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー費用等	42,900千円
-----------	----------

5. 発生した負ののれん発生益の金額、発生原因

(1) 発生した負ののれん発生益の金額

201,136千円

(2) 発生原因

取得時の時価純資産価額が取得原価を上回ったためであります。

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	5,457,874千円
固定資産	5,927,808千円
資産合計	11,385,682千円
流動負債	3,139,133千円
固定負債	323,284千円
負債合計	3,462,417千円

(株式取得による会社の取得)

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社ユニオンエレクトロニクス (現：株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション)

事業の内容 株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの管理・運営

(2) 企業結合を行った主な理由

株式会社ユニオンエレクトロニクスは株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの100%親会社であります。株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションは1967年設立の日本国内の総合電機部品商社で、日立パワーデバイスの第1号特約店(1971年)です。日立パワー半導体、ルネサスマイコンを中核とし、光伝送モジュール、産業用モータ、基板、中耐圧アナログ IC、MEMS、各種電子機器類、鉛フリーはんだ、電池等の製品をトータルで提供しております。当社の主要セグメントに半導体生産設備の買取・販売事業がありますが、本事業は近年、順調に成長してまいりました。この度、株式会社ユニオンエレクトロニクスを子会社化することで更なる本事業の拡大を目指します。

なお、平成30年10月に株式会社ユニオンエレクトロニクスと株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションは合併し、会社名を株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションとしております。

(3) 企業結合日

平成30年5月8日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

(5) 結合後企業の名称

株式会社ユニオンエレクトロニクス (現：株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション)

(6) 取得した議決権比率

100%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価とする株式取得により議決権の100%を取得したことによるものです。

2. 当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれている被取得企業の業績の期間
平成30年4月1日から平成30年12月31日まで
3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得金額については、売主との協議により非公開としておりますが、公平性・妥当性を確保するため、第三者機関による財務・法務調査結果資料を基に決定しております。
4. 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザー費用等 1,200千円
5. 発生した負ののれん発生益の金額、発生原因
 - (1) 発生した負ののれん発生益の金額
64,031千円
 - (2) 発生原因
取得時の時価純資産価額が取得原価を上回ったためであります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

当社グループは、報告セグメントを「ウェーハ事業」と「プライムシリコンウェーハ製造販売事業」、「半導体生産設備の買取・販売」の3事業としております。

「ウェーハ事業」は、半導体用シリコンウェーハの再生、加工及び販売を行っております。「プライムシリコンウェーハ製造販売事業」は製品用シリコンウェーハ（プライムシリコンウェーハ）の再生、加工及び販売を行っております。「半導体生産設備の買取・販売」は、主に中古の半導体関連機械装置（新品及び半導体以外も可）、消耗材を対象とするもので、主に中国市場へ販売を行っております。

(3) 報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、中国において「プライムシリコンウェーハ製造販売事業」に参入する目的で、第1四半期連結会計期間に北京有色金属研究総院及び福建倉元投資有限公司との合弁会社を設立し、北京有研RS半導体科技有限公司と有研半導体材料有限公司を子会社といたしました。

この結果、当連結会計年度より新たに報告セグメントの区分が一つ増えて、「ウェーハ事業」、「プライムシリコンウェーハ製造販売事業」、「半導体生産設備の買取・販売」の3区分に報告セグメントを変更しております。

なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しており、「3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連結会計年度に記載しております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸 表計上額 (注) 3
	ウェーハ 事業	プライム シリコン ウェーハ 製造販売 事業	半導体生 産設備の 買取・販 売	計				
売上高								
外部顧客への売上高	9,486,604	—	1,378,618	10,865,222	67,260	10,932,483	—	10,932,483
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	15,126	15,126	—	15,126	△15,126	—
計	9,486,604	—	1,393,744	10,880,348	67,260	10,947,609	△15,126	10,932,483
セグメント利益	3,396,027	—	129,675	3,525,702	40,062	3,565,765	△583,365	2,982,399
セグメント資産	8,120,340	—	1,304,695	9,425,036	319,015	9,744,051	2,486,840	12,230,892
その他の項目								
減価償却費	686,148	—	—	686,148	22,823	708,971	5,498	714,469
減損損失	—	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	80,549	—	—	80,549	—	80,549	14,889	95,438

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業と技術コンサルティングであります。

2. 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。

全社資産は主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係る増加額であります。

3. セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸 表計上額 (注) 3
	ウェーハ事 業	ブライムシ リコンウェ ーハ製造販 売事業	半導体生産 設備の買 取・販売	計				
売上高								
外部顧客への売上高	10,965,985	11,543,040	2,907,989	25,417,015	61,786	25,478,801	—	25,478,801
セグメント間の内部売上高又は振替高	7,927	375,653	10,129	393,710	—	393,710	△393,710	—
計	10,973,913	11,918,693	2,918,118	25,810,725	61,786	25,872,511	△393,710	25,478,801
セグメント利益	4,011,957	2,048,677	366,377	6,427,012	2,894	6,429,906	△678,354	5,751,552
セグメント資産	9,150,109	21,313,026	1,939,444	32,402,581	327,892	32,730,473	3,988,089	36,718,562
その他の項目								
減価償却費	703,329	561,885	5,694	1,270,909	22,823	1,293,733	4,726	1,298,459
減損損失	—	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	630,464	639,935	4,061	1,274,461	—	1,274,461	55,600	1,330,061

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業と技術コンサルティングであります。

2. 調整額は以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
- (2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。
全社資産は主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係る増加額であります。

3. セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1株当たり純資産額	494円20銭	1,417円95銭
1株当たり当期純利益金額	190円56銭	294円80銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	182円18銭	284円47銭

- (注) 1. 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の株式数については、従業員持株ESOP信託が所有する自己株式が当連結会計年度末には存在していないため控除しておりませんが、前連結会計年度末は4,300株を控除し算定しております。
2. 1株当たり当期純利益の算定に用いられた期中平均株式数については、従業員持株ESOP信託が所有する自己株式数2,868株(前連結会計年度5,405株)を控除し算定しております。
3. 平成29年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
4. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	2,113,030	3,620,811
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	2,113,030	3,620,811
普通株式の期中平均株式数(株)	11,088,730	12,282,456
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	510,103	445,960
(うち新株予約権(株))	510,103	445,960
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—

(重要な後発事象)

(株式取得による会社の取得)

当社は、平成30年11月13日開催の取締役会において、株式会社DG Technologiesの発行済株式を全て取得して当社の子会社とすることを決議し、平成31年1月10日に株式を取得して連結子会社といたしました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称およびその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社DG Technologies

事業の内容 半導体製造装置向けの消耗部材の製造・販売

(2) 企業結合を行う主な理由

株式会社DG Technologiesは半導体製造装置向けの消耗部材の製造・販売をトータルで提供しております。当社の主要セグメントに半導体生産設備の買取・販売事業がありますが、本事業は近年、順調に成長してまいりました。この度、株式会社DG Technologiesを子会社化することで、本事業とのシナジー効果を活用し、更なる本事業の拡大を目指します。

(3) 企業結合日

平成31年1月10日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

(5) 結合後企業の名称

株式会社DG Technologies

(6) 取得する議決権比率

100%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価とする株式取得により議決権の100%を取得することによるものです。

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得対価 現金 900,000千円

取得原価 900,000千円

3. 発生するのれんの金額、発生原因及び償却方法

現時点では確定しておりません。

4. 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

(重要な借入)

当社は、平成31年2月19日開催の取締役会決議に基づき、株式会社三菱UFJ銀行と下記ローン契約を平成31年2月22日付で締結し、同日付で借入を実行いたしました。

1. 資金用途

株式会社DG Technologies (子会社) 株式の取得及び当該子会社の借入金返済

2. 借入先の名称

株式会社三菱UFJ銀行

3. 借入金額及び利率

13億円、基準金利+0.3%

4. 借入実行日

平成31年2月22日

5. 担保提供資産

なし